

Mini-PFE 100 / 200

Präzise, physikalisch saubere Zelle



Ausrüstung zur kontinuierlichen automatischen Bearbeitung der Ober- und Unterseite streifenförmiger Werkstücke

Kleine Zellen mit breiter Kanone werden in der Elektroindustrie wie Leiterplatten oder Halbleiter eingesetzt. Durch die gleichmäßige Bearbeitung auf beiden Seiten kann es für Stab- und Blattform verwendet werden. Anwendbar für Keramik- und Cu-Platten.

Besonderheit

- Funktionen sind integriert, die Nassstrahl-Verarbeitungsqualität bleibt jedoch erhalten. Neu entwickelte Zelle als kleiner und kostensparender Zweck.
- Kompakte Strahl- und Wasserspülteile erleichtern die Wartung der Aktuatoren. Öffnen Sie einfach eine Förderbandabdeckung. Auch die breite Pistole und die Pumpe als Hauptteile weisen noch immer die ursprüngliche hohe Haltbarkeit auf.
- Angebot von 2 Typen (Mini-PFE 100/200) entsprechend der Werkstückgröße.

Spez

mini PFE 100

Größe	1200 (B) × 1250 (T) × 1600 (H) mm
Arbeitsgröße	Breite: 20-100 mm Länge: 100-250 mm Dicke: 0,1-1,5 mm
Transportgeschwindigkeit des Förderers	0,1-3,0 m/min
Pistole	Wide Pistole 110 mm Je eine für oben und unten
StromversorPistoleg	AC200V, 50/60Hz, 3 Phasen
Energieverbrauch	Etwa 2,6 kW (Gesamtnennscheinleistung aller Geräte)
LuftversorPistolegsdruck	0,5 MPa-0,7 MPa
Luftverbrauch	4,1m ³ /min (NTP bei 0,25 MPa des voreingestellten Strahlluftdrucks)

Mini-PFE 200

Größe	1200 (B) × 1650 (T) × 1650 (H) mm
Arbeitsgröße	Breite: 20-200 mm Länge: 100-250 mm Dicke: 0,1-1,5 mm
Transportgeschwindigkeit des Förderers	0,1-3,0 m/min
Gun	Wide Gun 220 mm Je eine für oben und unten
Stromversorgung	AC200V, 50/60Hz, 3 Phasen
Energieverbrauch	Etwa 4,3 kW (Gesamtnennscheinleistung aller Geräte)

Luftversorgungsdruck

0,5 MPa-0,7 MPa

Luftverbrauch

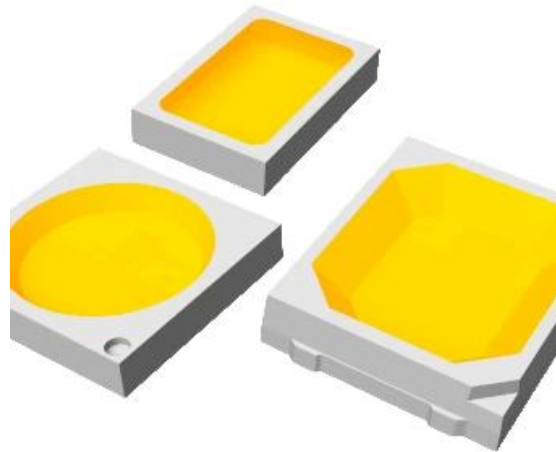
7,7 m³/min (NTP bei 0,25 MPa des voreingestellten Strahlluftdrucks)

Verwandte Seiten

Verwandte Anwendungen



[Vorbehandlung für die Galvanisierung, um Grate zu entfernen, ohne die Halbleiter zu beschädigen \(Entgratung\)](#)



[Methode zur Entfernung von umspritztem Harz, die Schäden an vergrabenen LED-Chips drastisch reduziert](#)



[Bearbeitungsmethode zur Entfernung dünner Grate \(Flash-Grat\) ohne Beschädigung des LED-Gehäuses](#)